



TG-NSP25 非矽型导热胶泥

Non-silicone Thermal Putty

RoHS Compliant

产品特性 Features

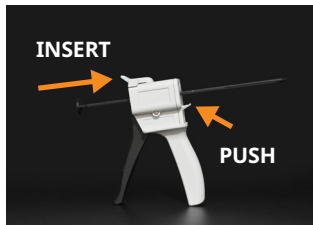
- 无矽成分的导热凝胶
Silicone free thermal gel
- 可任意塑形与下压
Shapeable and compressible
- 低热阻抗
Low thermal impedance
- 无液体流动现象之困扰
No fluidity

产品应用端 Application:

适用于高速低功耗晶片 Best for high-speed or middle-power chipset

电子元件 Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

操作说明 Operation Manual



① Push the latch and insert the stick.



② Put the tube in and twist.



③ Close the cover.

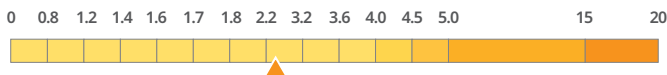


④ Take off the plug.

(图中操作步骤所展示的胶泥仅供示意 The putty in the picture does not represent the actual product.)

产品物性 Properties

导热系数 Thermal Conductivity : 2.6 W/m·K



Properties	Unit	TG-NSP25	Tolerance	Test Method
导热系数 Thermal Conductivity	W/m·K	2.6	±10%	ASTM D5470 Modified
颜色 Color	-	灰 Gray	-	-
黏度 Viscosity	Pa·s	5000	-	Brookfield
密度 Density	g/cm ³	2.6	-	ASTM D792
低分子矽氧烷 Low MW Siloxane (D3-10)	ppm	0	-	GC/MS
体积电阻率 Volume Resistivity	Ohm·m	10 ¹⁴	-	ASTM D257
工作温度 Operating Temperature	°C	-50~+150	-	-
标准包装 Standard Package	-	针筒 Tube/ 罐装 Pot	-	-

高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃园市桃园区大仁路 50 巷 33 号 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan

T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version19
20240517



注意：本技术数据表内的资讯是根据高柏团队的研究与测试得出的最佳数据。本技术数据表中列出的值仅代表典型值，并非对每一批生产的物料都进行测试。所有规格如有变更，恕不另行通知；无影响产品功能之保护膜及离型纸，如非特殊要求，皆依高柏默认为准。由于各种可能的使用条件超出了我们的控制范围，因此我们提出的所有建议均不构成保证或责任，用户应自行进行测试，以确定我们的产品在任何特定情况下的适用性。本产品的销售没有任何明示或暗示的说明，表示其适用于特定目的或其他用途的保证，但本产品应依据高柏与您确认的发票、报价、或订单，提供最标准的产品质量。我们不承担使用者如何延伸或改变此技术数据表中的资讯，使用者应承担所有风险。此外，本技术数据表中的资讯不包含任何内容解释与涉及产品材料的现有用途、未来专利冲突、工艺制造，与使用产品的建议。